

Список литературы

- [1] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982.
- [2] Абрикосов А.А. Основы теории металлов. М.: Наука, 1987.
- [3] Горьков Л.П., Конин Н.Б. // УФН. 1988. Т. 156. В. 1. С. 117-135.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
27 сентября 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 24

26 декабря 1989 г.

11

К ТЕОРИИ ВТОРИЧНОЙ ИОННОЙ ЭМИССИИ МЕТАЛЛОВ

А.Г. Борисов, И.Ф. Уразгильдин

Бомбардировка поверхности твердого тела ионным пучком сопровождается распылением частиц, покидающих поверхность в различных зарядовых состояниях. Исследование процессов формирования зарядового состояния вторичных частиц является важной задачей физики взаимодействия атомных частиц с твердым телом, представляющей большой практический интерес для диагностики поверхности.

Теоретические модели, описывающие резонансную перезарядку отлетающего иона с невозмущенной поверхностью, дают следующую зависимость для вероятности ионизации от нормальной к поверхности составляющей скорости иона v_{\perp} [1]:

$$\rho^+ \sim \exp(-v_0/v_{\perp}) \quad (1)$$

v_0 – параметр. Формула получена в предположении бесконечной ширины валентной зоны в металле. Как было экспериментально установлено [2], формула (1) не описывает поведение $P^+(E)$ в области малых энергий отлетающих частиц. Кроме того, при качественном совпадении теории и эксперимента в области энергий, отвечающих экспоненциальной зависимости (1), теория дает существенно завышенное значение для P^+ (на 2-3 порядка).

Рядом авторов показано, что отличие по форме между экспериментальными и теоретическими зависимостями $P^+(E)$ может быть уменьшено при учете: а) зависимости скорости отлетающей частицы от расстояния до поверхности [3]; б) конечного времени диффузии электрона в твердом теле [4]. Однако эти модели не устраниют расхождения в порядке величин.

Рис. 1. Влияние конечной ширины зоны на вероятность ионизации: расчет (1), эксперимент (2) [2].

Связано такое расхождение главным образом с тем, что существующие теории, учитывая изменение энергии основного состояния отлетающей частицы в зависимости от расстояния до поверхности, предполагают начальную разность энергий между уровнем Ферми и уровнем отлетающей частицы порядка нескольких эВ. Предположение справедливо для десорбции, в случае же распыления собственных атомов, когда основной уровень в начальный момент находится вблизи уровня Ферми, оно не приемлемо. Весьма существенно также влияние на вероятность ионизации ограниченности ширины энергетической зоны электронных состояний в металле.

С учетом данных факторов проводилось интегрирование нестационарного уравнения Шредингера. Расчет проводился на ЭВМ на основе динамического гамильтонiana Андерсена - Ньюса [5, 6]:

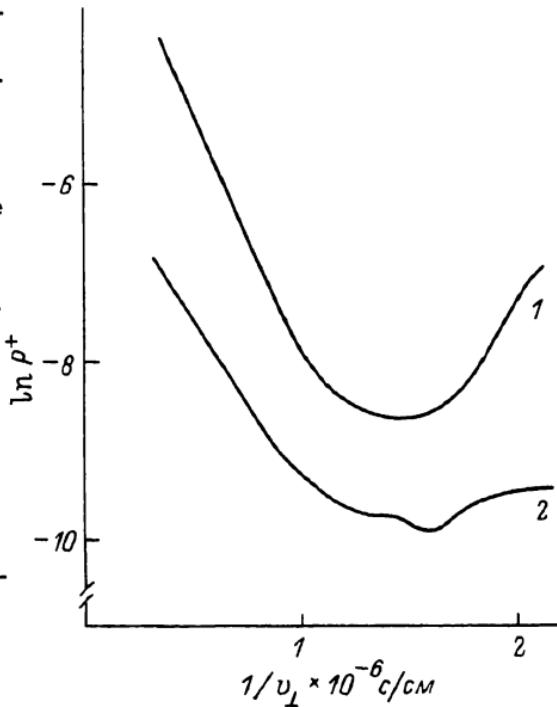
$$\hat{H}(t) = \mathcal{E}_a(t)|a\rangle\langle a| + \sum_k \mathcal{E}_k|k\rangle\langle k| + \sum_k (V_{ka}|k\rangle\langle a| + V_{ak}|a\rangle\langle k|),$$

приводящего к системе уравнений для чисел заполнения:

$$i\hbar \frac{\partial a}{\partial t} = \mathcal{E}_a(t)a + \sum_k V_{ak} b_k, \quad (2a)$$

$$i\hbar \frac{\partial b_k}{\partial t} = \mathcal{E}_k b_k + V_{ka}a, \quad (2b)$$

где $\mathcal{E}_a(t)$ - энергия основного состояния отлетающего иона [1], $|a\rangle$ - волновая функция электрона в этом состоянии; $\mathcal{E}_k, |k\rangle$ - энергия и волновая функция, отвечающие электронным состояниям в зоне; $V_{ak} = \langle a | \hat{V} | k \rangle$ - матричный элемент перехода, где \hat{V} - оператор возмущения, связанный со взаимодействием иона с поверхностью; $|b_k|^2$ - вероятность нахождения электрона на k -ом энергетическом уровне в зоне, $|a|^2$ - вероятность нахождения электрона в состоянии, связанном с основным уровнем иона (вероятность нейтрализации). Начальные условия предполагают отсутствие электрона в основном состоянии, расположенному незначительно выше уровня Ферми.



$$1/u_1 \times 10^{-6} \text{ с/см}$$

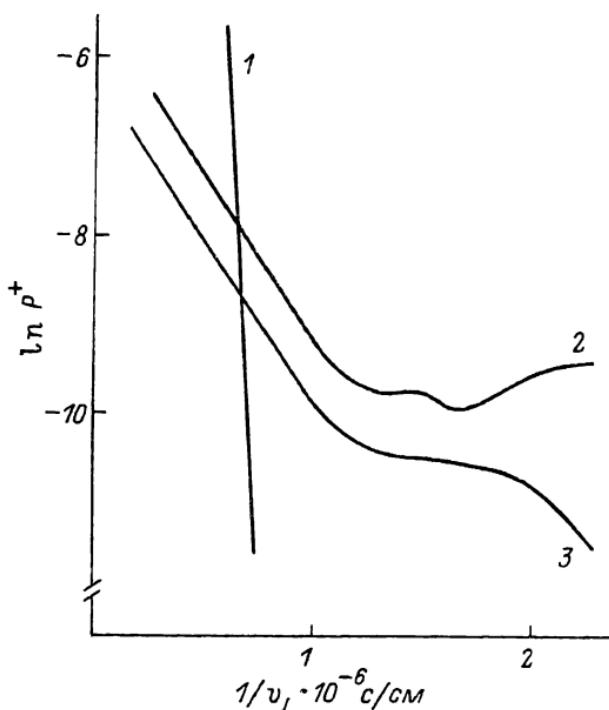


Рис. 2. Вероятность ионизации с учетом зависимости $H_0(E)$: теоретическая формула 1 (1), эксперимент (2) [2], теория с учетом зависимости $H_0(E)$ (3).

Было получено, что ход кривой $P^+(E)$ в области малых энергий существенно отличается от $\text{EXP}(-\nu_0/\nu_L)$ и приближается к экспериментально наблюдавшемуся (рис. 1).

Следующим важным моментом, по нашему мнению, является выбор V_{ak} . Обычно рассматривают V_{ak} в виде: $V_{ak} = H_0 \text{EXP}(-\gamma \nu_L t)$, где $\gamma^2/2$ – энергия связи электрона. При этом амплитуду обменного взаимодействия H_0 считают не зависящей от номера k и кинетической энергии отлетающего иона E . Вид V_{ak} не предполагает зависимости от условий получения распыляющего импульса. На самом деле распыляющий импульс передается в результате столкновения, которое и определяет скорость эмитируемой частицы. Таким образом, всегда можно выделить частицу или группу частиц, с которыми происходит взаимодействие в момент эмиссии. Очевидно, что начальная величина H_0 , определяемая перекрытием электронных оболочек, зависит от максимального сближения атомов.

Взаимодействие между атомами выбиралось в виде потенциала Морзе: $V = E_0 \{ \exp[-2\alpha(r-r_0)] - 2\exp[-\alpha(r-r_0)] \}$; E_0 – энергия связи, отвечающая положению равновесия r_0 ; r – расстояние между атомами. Сближение атомов r_{min} связано с энергией вторичной частицы и может быть оценено в предположении лобового удара при получении распыляющего импульса.

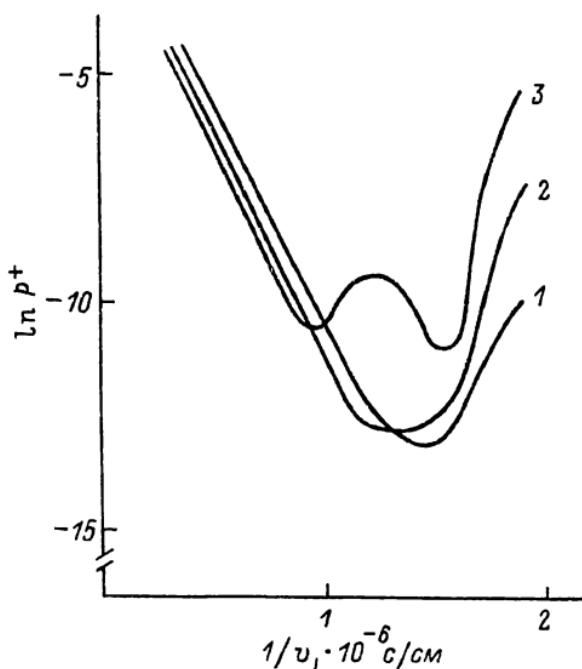


Рис. Влияние диффузии на вероятность ионизации P^+ для различных значений Γ : 0 эВ (1), 0.2 эВ (2), 0.5 эВ (3).

Кроме того, в области расстояний до поверхности, в пределах которой происходит интенсивный зарядовый обмен ($\sim 3 \text{ \AA}$), более отвечающей действительности является следующая форма обменного члена: $V_{ak} \sim \exp(-\gamma r^2)$, обусловленная, в частности, насыщением обменного взаимодействия на малых расстояниях.

На основе полученных значений для r_{min} вычислялись величины $H_0(E)$, которые подставлялись в теоретическую формулу (1), где $\sigma_0 \sim H_0^2$ [1]. Результат (рис. 2) демонстрирует значительное приближение по форме кривой и порядку величины $P^+(E)$ к экспериментальным зависимостям [2, 7].

На формирование зарядового состояния отлетающего иона существенное влияние оказывает характерное время пребывания электрона в области обмена. Оно определяется пространственной диффузией электрона в металле. Необходимо отметить, что система (2) не содержит члена, отвечающего за диффузию носителя заряда. В связи с этим попытка авторов [4] учесть диффузию, исходя из системы (2), представляется некорректной. Учет диффузии приводит к появлению в правой части уравнения (2б) члена: $-\epsilon \Gamma b_K$, где Γ — скорость диффузии. Полученные для различных Γ результаты представлены на рис. 3, из которого следует, что наиболее сильное изменение хода кривой $P^+(E)$ наблюдается в области малых скоростей.

Таким образом, в процессе вторичной ионной эмиссии существенную роль играет близость в начальный момент энергии основного

состояния отлетающей частицы к энергии Ферми; конечная ширина зоны электронных состояний в металле; зависимость амплитуды обменного взаимодействия от кинетической энергии эмитируемой частицы; пространственная диффузия носителя заряда в металле.

Список литературы

- [1] Lang N., Norskov J. // Physica Scripta. 1983. V. 6. P. 15-18.
- [2] Wucher A., Oechsner H. // Surface Sci. 1988. V. 199. P. 567-578.
- [3] Lang N. // Phys. Rev. B. 1983. V. 27. P. 2019-2020.
- [4] Sroubek Z., Falcone G. // Surface Sci. 1988. V. 197. P. 528-538.
- [5] Brakko R., Newns D.M. // Surface Sci. 1981. V. 108. P. 253-270.
- [6] Ледянкин Д.В., Уразгильдин И.Ф., Юрасова В.Е. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. № 12. С. 90-100.
- [7] O'Connor D.J., Shen Y.G., Wilson J.M., Mac Donald R.G. // Surface Sci. 1988. V. 197. P. 277-294.

Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
19 сентября 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 24

26 декабря 1989 г.

05.1

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА СКОРОСТЬ ВИНТОВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ В АНТИМОНИДЕ ИНДИЯ

В.И. Алексеенко, В.М. Мостовой

1. Старение дислокаций в щелочно-галоидных кристаллах изучалось в работах [1, 2]. Впервые задача об изучении кинетики подвижности индивидуальных дислокаций в кристаллах полупроводников, подвергнутых высокотемпературному отжигу, была поставлена в [3]. Было экспериментально показано, что предварительной высокотемпературный отжиг кристалла с дислокациями без внешней нагрузки приводит к резкому падению скорости дислокаций, тогда как подобный отжиг кристаллов с движущимися под действием внешней нагрузки дислокациями практически не оказывает влияния на их подвижность [4].